



1-2

Reference Number OG004428

Mailing Number 089312

Mailing Date 2003 March 18

1/3

OFFICIAL NOTICE OF REASON FOR REJECTION

Patent Application Number 2000 Patent Application No. 296328
Date of Draft 2003 March 12
JPO Examiner SAKAI HIDEO 2929 4R00
Agent of Patent Applicant ONISHI KENJI
Applied Articles Article 29-Paragraph 1, Article 29-Paragraph 2, Article 29.2

This application is to be rejected for the following reason. The argument should be submitted within 60 days of the mailing date of this official notice.

REASON

1. Since the inventions as defined in the following Claims of the present application indicate the inventions described in the following publications disseminated in Japan or foreign countries before the application thereof, the inventions correspond to the third of the first paragraph of Article 29 and hence a patent may not be obtained.

2. The invention in accordance with the following claims of this application shall not be granted a patent on the basis of Section 29 (2) of the Patent Law, because the invention could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains on the basis of an invention or inventions referred to inventions which were described in the following publication distributed in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application.

3. The inventions as defined in the following claims of the present application correspond to an application prior to the date of application thereof

and are identical with the inventions described in the specification or accompanying drawings firstly attached to the following filed application filed and opened after the application thereof. Besides, the inventors of the present application are not identical with persons having carried out the above inventions related to the application prior to its application. Upon this application, the applicant thereof is not identical either with the applicant of the patent application related to the application prior to its application. Therefore, a patent may not be obtained under Article 29.2.

REMARKS (Referring to a list of cited references with regard to cited references)

NOTICE OF REASON FOR REJECTION

Note (As to cited document, etc.,
see the list of cited documents, etc. below)

With regard to Reasons 1) and 2)

- Claims 8 to 10
- Cited Document 1, etc.
- Remark:

Refer particularly to Figs. 1 and 2. In the invention described in the Cited Document 1, two wires are connected in regions different in bonding pad (equivalent to "first electrode pad" in the present application).

With regard to Reason 2)

- Claims 1 to 7
- Cited Document 1, etc.

- Remark

It is perceived that since a lead frame and a substrate having wiring patterns formed on its surface are respectively well known as a base material on which a semiconductor element or chip is mounted, changing the lead frame according to the invention described in the Cited Document 1 to the substrate whose surface is formed with the wiring patterns could be easily made by those skilled in the art. There is not perceived any noticeable difficulty even in changing the shape of each electrode pad.

Further, a method of forming bumps on their corresponding electrode pads of a semiconductor element and effecting second bonding on the bumps is very well-known.

With regard to Reason 3)

- Claims 1 to 5 and 7 to 10
- Cited Document 2, etc.
- Remark

Refer particularly to Figs. 4 and 11. Since a method of forming bumps on their corresponding electrode pads of a semiconductor element and effecting second bonding on the bumps is very well-known, the invention according to claims 3 and 4 in the present application, and the invention described in the prior application 2 are substantially identical.

- Claims 11 to 13
- Cited Document 3, etc.
- Remark

Refer particularly to Fig. 5(c), Fig. 7 and the description of paragraph numbers [0090] - [0095].

List of cited documents, etc.

1. International Publication No. 97/25742 Pamphlet
2. Japanese Patent Application No. 2000-007923 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-196529)
3. Japanese Patent Application No. 2000-004034 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-307057)

* * * * *

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2000-296328
起案日 平成15年 3月12日
特許庁審査官 酒井 英夫 2929 4R00
特許出願人代理人 大西 健治 様
適用条文 第29条第1項、第29条第2項、第29条の2

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

3) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時に、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

理由1) 2) について

- ・請求項 8-10
- ・引用文献等 1
- ・備考

特に図1-2を参照。引用例1に記載の発明では、ボンディングパッド（本願の「第1の電極パッド」に相当）の異なる領域で2本のワイヤが接続されているものである。

S i S C
提出期限
5. 月 19日

理由2) について

- ・請求項 1-7
- ・引用文献等 1
- ・備考

半導体素子を搭載する基材として、リードフレームも表面に配線パターンが形成された基板もよく知られているものであるから、引用例1に記載の発明のリードフレームを表面に配線パターンが形成された基板に変更することは当業者が容易になしえたものである。電極パッドの形状を変更したことについても格別の困難性は認められない。

また、半導体素子の電極パッド上にバンプを形成し、その上にセカンドボンドを行う方法は非常によく知られた方法である。

理由3) について

- ・請求項 1-5, 7-10
- ・引用文献等 2
- ・備考

特に図4、図11を参照。半導体素子の電極パッド上にバンプを形成し、その上にセカンドボンドを行う方法は非常によく知られた方法であるから、本願請求項3-4に係る発明と先願2に記載の発明は実質的に同一である。

- ・請求項 11-13
- ・引用文献等 3
- ・備考

特に図5(c)、図7、段落番号【0090】-【0095】の記載を参照。

引用文献等一覧

1. 国際公開第97/25742号パンフレット
2. 特願2000-007923号(特開2001-196529号)
3. 特願2000-004034号(特開2000-307057号)

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版 H01L 25/065 - 25/07
- ・先行技術文献 特開2000-114452号公報
 特開2001-118877号公報

発送番号 089312

発送日 平成15年 3月18日 3 / 3

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 金属加工(電子素材加工) 和瀬田芳正

TEL. 03(3581)1101 内線3470 FAX. 03(3580)6905